

東北大学マイクロシステム融合研究開発センター 試作コインランドリ 主要装置リスト (2026年4月～)

■施設使用料 (1人あたり) 学外: 450円/時間、学内: 280円/時間

■技術支援料 6,514円/時間 (文科省マテリアル先端リサーチインフラ[ARIM]ご利用の場合、3,300円/時間) (改定前と同じ)

(税込)

分類	番号	ARIM 機器ID	装置名称	メーカー/型番	ARIM データ提供あり 使用料 (円/時間)	ARIM データ提供なし 使用料 (円/時間)	非公開利用 使用料 (円/時間)	改定前 ARIM データ提供時 使用料	改定前 ARIM 使用料	対応ウェハサイズ	備考/簡単な仕様、装置の特徴等
洗浄・乾燥	A-01	TU-001	エッチングチャンバー	アズワン PSH1200	2,090	2,772	3,344	2,134	2,838	最大8インチ	酸洗浄、ウェットエッチング (Si, SiO <sub>2</sub> , 金属など)
	A-02	TU-002	有機ドラフトチャンバー	-	2,046	2,728	3,278	2,112	2,816	最大6インチ	有機洗浄、レジスト剥離
	A-03	TU-003	リン酸槽	-	2,376	3,146	3,784	2,486	3,300	最大8インチ	SiNウェットエッチング
	A-04	TU-004	スピン乾燥機	東邦化成 ZAA-4	3,080	4,092	4,928	3,212	4,268	最大6インチ	平置き式でウェハやフォトマスクの乾燥
	A-05	TU-005	4"スピン乾燥機	SEMITOOL PSC101	3,498	4,642	5,588	3,630	4,818	4インチ	カセット式で1度に25枚まで処理可能
	A-06	TU-006	6"スピン乾燥機	SEMITOOL PSC101	3,498	4,642	5,588	3,630	4,818	6インチ	カセット式で1度に25枚まで処理可能
	A-07	TU-007	シンター用オープン	ヤマト科学 DR22	2,574	3,410	4,092	2,662	3,542	最大6インチ	N <sub>2</sub> 雰囲気中での熱処理、Alシンタリングなど
	A-08	TU-008	真空オープン	ヤマト科学 DP-31	1,738	2,310	2,772	1,782	2,376	最大8インチ	真空中での熱処理
	A-09	TU-009	ブラシスクラバ	全協化成 特注	7,128	9,504	11,418	7,436	9,900	最大6インチ	研磨後のウェハ洗浄
リソグラフィ	B-01	TU-051	ミカサ スピンコート	ミカサ 1H-DXII	2,772	3,696	4,444	2,882	3,828	最大4インチ	レジスト等のスピンコーティング
	B-02	TU-052	アクテス スピンコート#1	アクテス ASC-4000	2,904	3,872	4,664	3,014	4,004	最大6インチ	レジスト等のスピンコーティング
	B-03	TU-053	アクテス スピンコート#2	アクテス ASC-4000W	2,970	3,938	4,730	3,058	4,070	最大8インチ	レジスト等のスピンコーティング
	B-04	TU-054	ホットプレート	Shamal HHP-230SQ	1,650	2,200	2,640	1,716	2,288	最大8インチ	設定温度: 40~400℃、温度分布精度: ±1℃
	B-05	TU-055	クリーンオープン	ヤマト科学 DE62	3,872	5,148	6,182	4,026	5,346	最大8インチ	ウェハのベーク
	B-06	TU-056	両面アライナ #1	SUSS MA6/BA6	4,026	5,368	6,446	4,158	5,544	最大6インチ	コンタクト露光、片面・両面アライメント、接合時のアライメント
	B-07	TU-056	両面アライナ #2	SUSS MA6/BA6	4,026	5,368	6,446	4,158	5,544	最大6インチ	コンタクト露光、片面・両面アライメント、接合時のアライメント
	B-08	TU-057	レーザ描画装置	Heidelberg Instruments DWL2000CE	9,152	12,188	14,630	9,240	12,320	最大9インチ角	波長: 405nm、最小描画線幅: 0.7μm、マスク作製 (Cr, エマルジョン)、直接描画、グレイスケール露光
	B-09	TU-058	マスクレスアライナ	Heidelberg Instruments MLA150	6,314	8,404	10,098	6,314	8,404	最大8インチ角	波長: 405nm 375nm、最小描画線幅: 1μm、マスク作製 (Cr, エマルジョン)、超高速直接描画、裏面アライメント
	B-10	TU-059	スプレー現像装置	アクテス ADE-3000S	2,772	3,674	4,422	2,860	3,806	最大6インチ	現像液とリンス (水) をノズルから噴霧
	B-11	TU-060	現像ドラフト	-	2,112	2,794	3,366	2,112	2,816	最大6インチ	レジスト現像用のドラフトチャンバー
	B-12	TU-061	スピン乾燥機	東邦化成 ZAA-4	2,816	3,740	4,488	2,904	3,850	最大6インチ	平置き式でウェハやフォトマスクの乾燥
	B-13	TU-062	コートデベロッパ	Suss ACS200Gen3	11,814	15,752	18,920	12,364	16,478	最大8インチ	2~8インチ、HMDS処理、コート 3ライン、現像 2ライン、エッチリンス、バックリンス、ホットプレート 4セット、クールプレート 1セット
	B-14	TU-063	線ステップ	キヤノン FPA-3030i5+	21,252	28,314	49,500	21,252	28,314	最大8インチ	小片~8インチ、最小線幅 0.35μm以下、重ね合せ精度 40nm、両面アライメント対応、透明基板対応、反り基板対応、Nikonレチクル対応
	B-15	TU-064	エリオニクス 130kV EB描画装置	エリオニクス ELS-G125S	10,428	13,882	16,676	10,164	13,530	最大6インチ	最大加速電圧: 130keV、最小描画パターン: 10nm以下
	B-16	TU-065	エリオニクス50kV EB描画装置	エリオニクス ELS-7500X	4,466	5,940	7,128	4,378	5,830	最大4インチ	最大加速電圧: 50keV
	B-17	TU-066	ポリミドキュア炉	ヤマト科学 DN43H	2,464	3,278	3,938	2,574	3,432	最大8インチ	N <sub>2</sub> 雰囲気中でのポリミドのキュア
	B-18	TU-067	UV キュア装置	ウシオ電機 UMA-802	4,774	6,358	7,634	4,774	6,358	4インチ	レジストのキュア、カセットtoカセット
	B-19	TU-068	球面露光装置	東栄科学産業 -	4,422	5,874	7,062	4,532	6,028	球面体	球面体 (直径1.0、3.3mm) へのマスクレス露光、最小パターン: 1.5μmハーピッチ、アライメント精度: ±5μm
	B-20	TU-069	両面アライナ #3	SUSS MA8/BA8 Gen3	5,170	6,886	8,272	5,368	7,150	最大6インチ	コンタクト露光、片面・両面アライメント
	B-21	TU-070	BEAMER PC		1,826	2,420	2,904	1,826	2,420		近接補正用ソフト(BEAMER)
	B-22	TU-071	KrFステップ	キヤノン FPA-3030EX6	30,426	40,546	60,500		新規	最大8インチ	小片~8インチ、最小線幅 0.15μm以下、重ね合せ精度 20nm、透明基板対応、反り基板対応
	B-23	TU-072	マスクレスアライナ#2	Heidelberg Instruments MLA150	7,194	9,570	11,484		新規	最大8インチ角	波長: 405nm 375nm、最小描画線幅: 1μm、マスク作製 (Cr, エマルジョン)、超高速直接描画、裏面アライメント、375nmレーザ強度増強
酸化拡散・イオン注入・熱処理	C-01	TU-101	酸化炉 (半導体)	東京エレクトロ XL-7	12,914	17,204	20,658	13,530	18,040	最大6インチ	酸化膜形成、半導体ウェハ用
	C-02	TU-101	酸化炉 (MEMS)	東京エレクトロ XL-7	10,384	13,838	16,610	10,802	14,388	最大6インチ	酸化膜形成、MEMSウェハ用
	C-03	TU-102	酸化炉 (8")	光洋サーモシステム MT-10x8-A	9,438	12,562	15,092	9,878	13,156	最大8インチ	酸化膜形成、8インチ用
	C-04	TU-103	拡散炉 (P拡散炉)	東京エレクトロ XL-7	13,684	18,238	21,890	14,388	19,184	最大6インチ	P拡散 (フリテボ用)
	C-05	TU-103	拡散炉 (P押し込み炉)	東京エレクトロ XL-7	13,530	18,040	21,648	13,662	18,194	最大6インチ	P拡散 (ドライブイン用)
	C-06	TU-103	拡散炉 (B拡散炉)	東京エレクトロ XL-7	13,464	17,930	21,516	13,816	18,414	最大6インチ	B拡散 (フリテボ用)
	C-07	TU-103	拡散炉 (B押し込み炉)	東京エレクトロ XL-7	12,078	16,104	19,338	12,320	16,412	最大6インチ	B拡散 (ドライブイン用)
	C-08	TU-104	メタル拡散炉	光洋リンドバグ Model270	9,328	12,430	14,916	9,702	12,914	最大4インチ	最高温度: 1000℃、メタルや圧電基板等の多用途拡散
	C-09	TU-105	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 NH-20SR	22,506	30,008	36,014	22,506	30,008	最大4インチ	最大加速電圧: 180keV、最大電流: 0.6mA、注入可能元素: P、B、カセットtoカセット
	C-10	TU-106	アニール炉	東京エレクトロ XL-7	11,858	15,796	18,964	12,100	16,126	最大6インチ	イオン注入後のアニール
	C-11	TU-107	ランプアニール装置	AG Associates AG4100	9,108	12,144	14,586	9,460	12,606	最大6インチ	最高温度: 1100℃、昇温速度: 100℃/sec、カセットtoカセット
	C-12	TU-108	水素アニール炉	オリジナル -	20,812	27,742	33,308	20,856	27,786	最大6インチ	最高温度: 1100℃、クリーンな環境下での赤外線ランプ加熱、Si専用
	C-13	TU-109	真空アニール炉	真空理工 RHL-Pss98/98#	6,776	9,020	10,824	6,974	9,284	最大4インチ	真空中での熱処理 (酸素、窒素雰囲気中の処理対応未確認)
成膜	D-01	TU-151	LPCVD (SiN)	システムサービス -	12,672	16,896	20,284	13,046	17,380	最大6インチ	SiN
	D-02	TU-151	LPCVD (Poly-Si)	システムサービス -	17,050	22,726	27,280	17,578	23,430	最大6インチ	Poly-Si
	D-03	TU-151	LPCVD (SiO <sub>2</sub> , SiON)	システムサービス -	14,432	19,228	23,078	14,872	19,822	最大6インチ	SiO <sub>2</sub> (NSG)、SiON
	D-04	TU-152	熱CVD	国際電気 -	28,028	37,356	44,836	29,370	39,160	最大6インチ	Epipoly-Si(non-doped, doped)、Poly-Si(non-doped, doped)、最高温度: 1100℃
	D-05	TU-153	住友精密PECVD	住友精密工業 MPX-CVD	19,558	26,070	31,284	20,394	27,170	最大8インチ	SiN、SiO <sub>2</sub> 、最高温度: 350℃、低応力SiN成膜
	D-06	TU-154	住友精密TEOS PECVD	住友精密工業 MPX-CVD	20,922	27,874	37,400	21,780	29,040	最大8インチ	TEOS SiO <sub>2</sub> 、SiN、最高温度: 350℃、低応力成膜
	D-07	TU-155	SPPテクノロジーズ TEOS PECVD	SPPテクノロジーズ APX-Cetus	21,450	28,600	38,500	21,956	29,260	最大8インチ	TEOS SiO <sub>2</sub> 、SiN、基板サイズ 小片~8インチ、最高温度 350℃、低応力SiN成膜
	D-08	TU-156	JPEL PECVD	日本生産技術研究所 VDS-5600	14,036	18,700	22,440	14,058	18,722	最大6インチ	SiN、SiO <sub>2</sub> 、バッチ式: 4インチ×13枚、6インチ×8枚
	D-09	TU-157	W-CVD	Applied Materials P-5000	11,594	15,444	18,546	11,770	15,686	4インチ	タングステン成膜
	D-10	TU-158	芝浦スバツ装置 (加熱型)	芝浦メカトロニクス CFS-4ESII	4,620	6,160	7,392	4,818	6,424	最大8インチ	基板ステージφ200mm、3インチターゲット×3、基板加熱形 (最高300℃)
	D-11	TU-159	芝浦スバツ装置 (冷却型)	芝浦メカトロニクス CFS-4ESII	4,642	6,182	7,436	4,862	6,468	最大8インチ	基板ステージφ200mm、3インチターゲット×3、基板水冷形、リフトオフプロセス可
	D-12	TU-160	自動搬送 芝浦スバツ装置	芝浦メカトロニクス I-Miller CFS-4EP-LL	6,710	8,932	10,736	6,996	9,328	最大8インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形 (最高300℃)、ロードロック付、自動搬送付
	D-13	TU-161	自動搬送 芝浦スバツ装置(冷却型)	芝浦メカトロニクス I-Miller CFS-4EP-LL	8,272	11,022	13,244	8,646	11,528	最大8インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック付、自動搬送付
	D-14	TU-162	ECRロングスローバツタ	エリオニクス EIS-200ERP-NPD-TK	6,138	8,162	9,812	6,424	8,558	最大6インチ	小片~6インチ、ターゲット数 2、ターゲット-ステージ間距離 150mm、コリメータ付、エッチング可
	D-15	TU-163	アネルバマルチスバツタ	アネルバ SPC-350	5,874	7,832	9,416	5,984	7,964	4インチ	1バッチ最大6枚搭載可能 (回転機構付)、6インチターゲット×3 (DC×2、RF×1: 同時放電可能)、基板加熱形 (最高650℃)、強磁性体対応、ロードロック付、クライオポンプ
	D-16	TU-164	酸素加圧RTA付高温スバツタ装置	ユーテック 21-0604	13,310	17,732	21,296	13,508	17,996	最大8インチ	金属用(DC)スバツタチャンバ、酸化物用(RF)スバツタチャンバ、酸素加圧アニールチャンバの3つのチャンバで構成。最高基板温度は700℃。主にPZT下地成膜、PZT成膜用。
	D-17	TU-165	アネルバスバツタ装置	アネルバ SPF-730	8,558	11,396	13,684	8,778	11,682	最大6インチ	1バッチ9枚 (4インチ)、8インチターゲット×3
	D-18	TU-166	球面成膜用スバツタ装置	和泉テック -	4,972	6,622	7,964	5,214	6,930	球面体	球面体 (直径1.0、3.3mm) へのスパッタリング、膜種: Au、Cr、Al、Pd、SiO <sub>2</sub> 他、O <sub>2</sub> プラズマクリーニング可
	D-19	TU-167	電子ビーム蒸着装置	アネルバ EVC-1501	7,656	10,208	12,254	7,722	10,274	最大6インチ	主に金属薄膜の蒸着
	D-20	TU-168	めっき装置	山本鍍金試験器 特注	2,706	3,586	4,312	2,816	3,740	最大6インチ	Cu、Ni、Sn、Au
	D-21	TU-169	多元材料原子層堆積(ALD)装置	テクノファイン ALK-600	10,186	13,574	16,302	10,340	13,772	最大6インチ	アルミナ等のALDが可能。6インチウェハまでの導入が可能。アルミナ以外は、要原料。
	D-22	TU-170	ソルゲル自動成膜装置	テクノファイン PZ-604	8,602	11,462	13,772	8,778	11,704	最大4インチ	PZT成膜
	D-23	TU-171	MOCVD	ワコム研究所 Doctor-T'	17,798	23,716	28,468	17,798	23,716	最大8インチ	PZT成膜等
	D-24	TU-172	シンクロン スバツタ装置	シンクロン RAS-1100B II	58,080	77,440	99,000	59,334	79,112	4インチ	36枚同時成膜が可能。Si、Ta、Al、W、SiO <sub>2</sub> 、Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 成膜可能。

エ ッ チ ン グ	E-01	TU-201	DeepRIE装置#1	住友精密工業 MUC-Z1 ASE-SBF	9,152	12,188	14,630	9,372	12,474	最大6インチ	Siの深堀エッチング、メカニカルチャック
	E-02	TU-202	DeepRIE装置#2	住友精密工業 MUC-Z1 ASE-SBF	9,152	12,188	14,630	9,372	12,474	最大6インチ	Siの深堀エッチング、メカニカルチャック
	E-03	TU-203	DeepRIE装置#3	STS Multiplex-ICP SR	9,834	13,090	15,708	9,988	13,310	最大6インチ	Siの深堀エッチング、メカニカルチャック
	E-04	TU-204	DeepRIE装置#4	住友精密工業 MUC-Z1 ASE-HR	15,928	21,230	25,476	16,368	21,824	最大8インチ	Siの深堀エッチング、静電チャック
	E-05	TU-205	アルバックICP-RIE#1	アルバック NE-550	18,898	25,190	30,228	19,206	25,586	最大6インチ	SiO <sub>2</sub> 、メタルなどの多目的ドライエッチング、静電チャック、ガス：CF <sub>4</sub> 、CHF <sub>3</sub> 、SF <sub>6</sub> 、Ar、O <sub>2</sub> 、N <sub>2</sub> 、Cl <sub>2</sub> 、BCl <sub>3</sub>
	E-06	TU-206	アルバックICP-RIE#2	アルバック CE-300I	17,600	23,452	28,160	18,150	24,200	最大6インチ	SiO <sub>2</sub> 、メタルなどの多目的ドライエッチング、静電チャック、ガス：CF <sub>4</sub> 、CHF <sub>3</sub> 、SF <sub>6</sub> 、Ar、O <sub>2</sub> 、N <sub>2</sub> 、Cl <sub>2</sub> 、BCl <sub>3</sub>
	E-07	TU-207	アルバック多用途RIE装置	アルバック RIH-1515Z	11,220	14,938	17,930	11,748	15,664	最大6インチ	金属膜や圧電膜も対象とした多目的のドライエッチング、ガス：Cl <sub>2</sub> 、BCl <sub>3</sub> 、SF <sub>6</sub> 、CF <sub>4</sub> 、CHF <sub>3</sub> 、Ar、N <sub>2</sub> 、O <sub>2</sub>
	E-08	TU-208	アネルバRIE装置	アネルバ DEA-506	9,086	12,100	14,520	9,086	12,100	最大8インチ	SiN、SiO <sub>2</sub> のドライエッチング、ガス：CF <sub>4</sub> 、CHF <sub>3</sub>
	E-09	TU-209	アネルバSi RIE装置	アネルバ L-507DL	7,172	9,548	11,462	7,172	9,548	最大6インチ	Siのドライエッチング、ガス：SF <sub>6</sub>
	E-11	TU-211	プラズマクリーナー	ヤマト科学 PDC210	3,674	4,884	5,874	3,828	5,104	最大6インチ	O <sub>2</sub> またはArによるウェハ表面のプラズマクリーニング、レジストアッシング
	E-12	TU-212	アルバック アッシング装置	アルバック UNA-2000	4,774	6,358	7,634	4,950	6,578	最大6インチ	2.45GH z、カセットtoカセット
	E-13	TU-213	ブランソン アッシング装置	ブランソン IPC4000	4,400	5,852	7,040	4,576	6,094	最大6インチ	13.56MH z
	E-14	TU-214	ケミカルドライエッチャー(CDE)	芝浦メカトロニクス CDE7	7,040	9,372	11,264	7,282	9,702	最大4インチ	フッカルによる低ダメージのSi、SiN等方向性ドライエッチング、DRIE後のスキップ除去、ガス：CF <sub>4</sub> 、O <sub>2</sub> 、N <sub>2</sub>
	E-15	TU-215	イオンミリング装置	エヌ・エス/伯東 20IBE-C	10,692	14,234	17,094	11,022	14,674	最大6インチ	Arイオン、4インチ×6枚、6インチ×3枚
	E-16	TU-216	Vapor HFエッチング装置	住友精密工業 Primaxx uEtch	9,218	12,276	14,740	9,548	12,716	最大6インチ	気相フッ酸による主にSiO <sub>2</sub> 犠牲層エッチング
	E-17	TU-217	KOHエッチング槽	-	3,168	4,224	5,082	3,300	4,378	最大6インチ	Si結晶異方性エッチング
	E-18	TU-218	TMAHエッチング槽	-	3,894	5,170	6,204	4,026	5,368	最大6インチ	Si結晶異方性エッチング
	E-19	TU-219	NLDエッチング装置	アルバック NLD-5700	22,704	30,250	38,500		新規	最大8インチ	磁気中性子線による低真空プラズマエッチング：SiCや石英などの難エッチング材料向けの多目的ドライエッチング、ガス：CF <sub>4</sub> 、CHF <sub>3</sub> 、SF <sub>6</sub> 、C <sub>4</sub> F <sub>8</sub> 、Ar、O <sub>2</sub> 、N <sub>2</sub> 、Cl <sub>2</sub> 、BCl <sub>3</sub>
	接 合 ・ 研 磨 ・ パ ッ ケ ー ジ ン グ	F-01	TU-251	SUSS ウェハ接合装置	SUSS SB6e	7,326	9,746	11,704	7,502	9,988	最大6インチ
F-02		TU-252	EVG ウェハ接合用アライナ	EVG Smart View Aligner	5,742	7,656	9,196	5,918	7,876	最大8インチ	IR透過アライメント可能
F-03		TU-253	EVG ウェハ接合装置	EVG 520	6,182	8,228	9,878	6,358	8,470	最大8インチ	熱圧着接合用
F-04		TU-254	EVG プラズマ活性化装置	EVG 810	8,118	10,802	12,980	8,382	11,176	最大6インチ	直接接合前のプラズマ活性化処理 標準ガス：N <sub>2</sub>
F-05		TU-255	ディスコ ダイヤ	ディスコ DAD-522	3,366	4,466	5,368	3,432	4,576	最大6インチ	切削水：水道水
F-06		TU-256	東京精密 ダイヤ	東京精密 0	9,900	13,200	15,840	10,164	13,530	最大6インチ	切削水：純水
F-07		TU-257	ワイヤボンダ	Westbond -	1,826	2,420	2,904	1,870	2,486	チップ	Al、Au
F-09		TU-259	サンドブラスト	新東 -	5,082	6,754	8,118	5,060	6,732	最大6インチ	ガラスの穴あけ加工
F-10		TU-260	4インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー Bni52	2,024	2,684	3,234	2,046	2,706	最大4インチ	Si、SiO <sub>2</sub> 、金属などの研磨、CMP
F-11		TU-261	6インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー Bni62	2,288	3,036	3,652	2,310	3,058	最大6インチ	Si、SiO <sub>2</sub> 、金属などの研磨、CMP
F-12		TU-262	サーフェイスプレーナー	ディスコ DAS8920	18,524	24,684	29,634	18,810	25,080	4、8インチ	Au、Cuパンプの平坦化
測 定	F-13	TU-263	UVインプリント装置	東芝機械 ST-50	6,600	8,800	10,560	6,622	8,822	最大4インチ角	UV光を用いたインプリント装置、ステップ&リピート可能
	F-14	TU-264	熱インプリント装置	オリジン電気 Reprina-T50A	5,962	7,942	9,548	6,204	8,272	最大2インチ角	最大650℃、最大30kN
	F-15	TU-265	エキシマ洗浄装置	デアネヒステ EXC-1201-DN	3,410	4,532	5,456	3,498	4,664	最大4インチ	ウェハや石英モールド上の有機物の除去
	F-16	TU-266	セミオートワイヤボンダ	TPT HB16 セミオート	1,738	2,310	2,772	1,804	2,398		ボールボンダ、ウェッジボンダの両方が可能、セミオート対応
	F-17	TU-267	サブフェルト・インクジェット	SIJテクノロジー PR150-THU	4,290	5,720	6,864	4,422	5,874		最小線幅：約5um
	F-18	TU-268	光造形3Dプリンター	シーファース 028) plus Build size: 90x90x90mm Layer thickness (min): 0.01mm XY accuracy: 0.022mm	2,838	3,762	4,532	2,948	3,916		最小積層ピッチ：0.01mm、最大造形サイズ：90mm x 90mm x 90mm
	F-19	TU-269	マイクロマニピュレータ	マイクロサポート	1,870	2,486	2,992	1,936	2,574		マイクロスコープ一体型マイクロマニピュレータシステム
	F-20	TU-270	ウォーターレーザ	滋谷工業 LAMICS AQL-1900	6,534	8,690	10,428	6,732	8,954	最大12インチ	シリコンウェハや金属薄板の加工 (ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅：約70um
	G-01	TU-301	ウェハG膜検査装置	トプコン WM-3	2,728	3,630	4,356	2,728	3,630	最大6インチ	ウェハ上のパーティクル測定 (数、大きさ)
	G-02	TU-302	膜厚計	ナノメトリクス NanoSpec3000	2,002	2,662	3,212	2,112	2,794	最大6インチ	光学式の膜厚測定
G-03	TU-303	卓上型エリプソ	フォトニクス SE-101	1,276	1,694	2,046	1,320	1,760	最大6インチ	高速サンプリング可能なエリプソ	
G-04	TU-304	エリプソ	アルバック -	1,562	2,068	2,486	1,606	2,134	最大6インチ	薄膜の厚さ、屈折率測定	
G-05	TU-305	Dektak 段差計	Dektak 8	2,266	3,014	3,630	2,376	3,146	最大6インチ	触針式の表面形状測定	
G-06	TU-306	Tencor 段差計	Tencor AlphaStep	2,244	2,992	3,608	2,332	3,102	最大6インチ	触針式の表面形状測定	
G-07	TU-307	金属顕微鏡	ニコン L150、L200	1,958	2,596	3,124	2,002	2,662	最大6インチ	パターン観察	
G-08	TU-308	デジタル顕微鏡	キーエンス/クノーテックノクラフト -	2,222	2,948	3,542	2,288	3,036	最大8インチ	パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ (PC制御可)、20~200倍、500~5000倍	
G-09	TU-309	赤外線顕微鏡	オリンパス/浜松ホトニクス -	1,848	2,464	2,970	1,914	2,552	最大6インチ	両面アライメントの確認、ウェハ接合面のボイド評価等	
G-10	TU-310	レーザ/白色共焦点顕微鏡	レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD	5,390	7,172	8,624	5,610	7,480	最大6インチ	3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能	
G-11	TU-311	深さ測定装置	ユニオン光学 Hisomet	1,540	2,046	2,464	1,606	2,134	最大6インチ	光学式の高精度深さ測定装置	
G-12	TU-312	超音波顕微鏡	インサイト IS-350	2,376	3,146	3,784	2,464	3,278	最大12インチ	デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ボイド評価等	
G-13	TU-313	マイクロX線CT	コムキヤンテック ScanXmate D160TS110	3,806	5,060	6,072	4,004	5,324	最大6インチ	X線を用いた非破壊内部観察	
G-14	TU-314	熱電子SEM	日立ハイテク S3700N	4,136	5,500	6,600	4,290	5,698	最大12インチ	EDX付、低真空モード付、光学画像ナビゲーション付	
G-15	TU-315	断面SEM	日立ハイテク S5000	5,742	7,656	9,196	5,962	7,942	小片	小片専用、インレンス式の高分解能FESEM	
G-17	TU-317	測長SEM	日立ハイテク CS4800	17,380	23,166	27,808	18,062	24,068	最大8インチ	微細構造の高精度自動測長 6、8インチは自動搬送、4インチ以下は手動搬送 計測再現性：1nm(3σ)	
G-18	TU-318	クイックコータ	サンヨー電子 SC-701MkII	1,782	2,354	2,838	1,848	2,442	最大2インチ	SEM観察試料のPtコーティング	
G-19	TU-319	パーク・システムズAFM	パーク・システムズ NX20	3,630	4,840	5,808	3,674	4,884	最大8インチ	小片から8インチまで対応する原子間力顕微鏡	
G-20	TU-320	4探針測定装置	-	1,452	1,936	2,332	1,518	2,002	最大6インチ	ウェハ抵抗率などの測定	
G-21	TU-321	拡がり抵抗測定装置	Solid State Measurement SSM150	2,816	3,740	4,488	2,882	3,828	小片	不純物濃度プロファイルの測定、ウェハを小片にして端面を斜め研磨した後に測定	
G-22	TU-322	FIB	SII SMI9200	10,010	13,332	16,016	10,010	13,332	小片	集束イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製	
G-23	TU-323	XRD	ブルカー・レイックスエス D8 DISCOVER	10,384	13,838	16,610	10,648	14,190	最大6インチ	X線回折測定、1000℃までの高温環境での測定可能	
G-24	TU-324	直線集束電子顕微鏡システム#1	オリジナル -	3,608	4,796	5,764	3,696	4,928	最大6インチ	固体試料の漏洩弾性表面波(LSAW)速度測定	
G-26	TU-326	Zygo Nexview	Zygo	2,904	3,872	4,664	2,970	3,938	最大6インチ	表面形状の精密測定	
G-27	TU-327	半導体パラメータアナライザ	Key Sight B1500A SMU B1511B x4 GNDU B1500-66605	1,606	2,134	2,574	1,672	2,222		半導体デバイスの特性評価	
G-28	TU-328	2光子励起顕微鏡	ライカ	3,630	4,840	5,808	3,630	4,840		マルチフォトンレーザ顕微鏡システム、超解像オプション付、細胞の高精細蛍光イメージング	
G-29	TU-329	分光エリプソ	ジェー・イー・ウーラム・ジャパン株式会社 RC2-UI-TTK	6,358	8,470	10,164	6,358	8,470	最大8インチ	測定波長域：210~1690 nm、入射角可変範囲：45~90度、ビーム径：通常3 mm サンプリング：φ200 mm (自動マッピング、自動アライメント機構付) 測定データ：分光エリプソメトリデータ (Ψ Δ)、ミューラー行列16成分、透過率、反射率、偏光消度 解析ソフトウェア：CompleteEASE	
G-30	TU-330	KLA Tencor 段差計#2	KLA Tencor P-160F+	2,948	3,916	4,708		新規	最大8インチ	触針式の表面形状測定	
G-31	TU-331	日立FE-SEM	日立ハイテク SU8600	6,952	9,262	11,132		新規	最大8インチ	EDX付、低真空モード付、光学画像ナビゲーション付	